

การออกแบบวงจรวัดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำและกินกำลังไฟต่ำ

นายโอมรินทร์ สาธุเสน

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-53-1312-2

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A DESIGN OF A LOW VOLTAGE AND LOW POWER DIGITAL TEMPERATURE SENSOR

Mr.Ohmmarin Sathusen

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-53-1312-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การออกแบบจรวดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำและกินกำลังไฟต่ำ
โดย นายโอมรินทร์ สาครเสน
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลาธรรมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยสุณิ วงศ์โคเมท

คณะกรรมการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลาธรรมี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยสุณิ วงศ์โคเมท)
..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม ໂປຣາ)

โอมรินทร์ สาธุเสน : การออกแบบจรวดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำและกินกำลังไฟต่ำ.

(A DESIGN OF A LOW VOLTAGE AND LOW POWER DIGITAL TEMPERATURE SENSOR) อ. ทีปรีกษา : รศ.ดร. เอกชัย ลีลาธรรม อาจารย์ที่ปรีกษาawan : ผศ.ดร.

นัยวุฒิ วงศ์โคเมท, 87 หน้า. ISBN 974-53-1312-2.

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบจรวดอุณหภูมิที่ใช้แรงดันต่ำ และกินกำลังไฟต่ำ ที่มีช่วงอุณหภูมิในการวัดตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส การออกแบบอาศัยหลักการผลิต่างช่องว่างพลังงานของซิลิคอนเพื่อสร้างกระแสที่แปรผันตามอุณหภูมิ หรือกระแสพีแทต ส่วนประกอบของวงจรแบ่งอยู่ออกได้เป็น 3 ส่วน คือ วงจรดัดอุณหภูมิและสร้างกระแสอ้างอิง ตัวแปลงสัญญาณและล็อกเป็นดิจิทัลแบบซิกมาเดลต้า และวงจรควบคุมภาคดิจิทัล วงจรรวมนี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบบลูuetoothด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) ทำให้สามารถวัดแบบไร้สายได้ วงจรต้นแบบออกแบบด้วยเทคโนโลยีซีมอล 0.35 ไมโครเมตร มีพื้นที่ซึ่งปะรุงทั้งแพดสำหรับทดสอบประมาณ 0.4 ตารางมิลลิเมตร ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า วงจรสามารถทำงานได้ที่แรงดันไฟเลี้ยงตั้งแต่ 2 ถึง 3.3 โวลต์ และมีความละเอียด 10 บิต หรือประมาณ 0.19 องศาเซลเซียส วงจรดังกล่าวกินกำลังทางไฟฟ้าเฉลี่ย 20.45 ไมโครวัตต์ ที่แรงดันไฟเลี้ยง 2.4 โวลต์และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เมื่อใช้งานร่วมกับชิป RFID ความละเอียดลดลงจะเหลือ 8 บิต หรือประมาณ 0.76 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพราะผลของสัญญาณรบกวนจากซับสเตอร์ของวงจร และระดับแรงดันไฟเลี้ยงภายในชิป โดยหลังการปรับเทียบแบบหนึ่งจุดค่าความผิดพลาดมีค่าไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ในช่วงการวัด 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยบรพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	ลายมือชื่อนิสิต	
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรีกษา	
ปีการศึกษา	2547	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรีกษาawan	

4670619721 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING

KEY WORD : TEMPERATURE SENSOR / PTAT CURRENT SOURCE / SIGMA-DELTA
ADC / RFID

OHMMARIN SATHUSEN : A DESIGN OF A LOW VOLTAGE AND LOW POWER
DIGITAL TEMPERATURE SENSOR . THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.
EKACHAI LEELARASMEE, Ph.D. THESIS COADVISOR : ASST.PROF.
NAIYAVUDHI WONGKOMET, Ph.D., 87 pp. ISBN 974-53-1312-2.

This thesis presents a design of a low-voltage and low-power digital temperature sensor with a measurement range of -40°C to 120°C . A temperature sensor is derived from a PTAT current source. The circuit is composed of three major blocks: a temperature sensor with reference current source, a first order sigma delta analog to digital converter and a digital circuit controller. The circuit is integrated into an RFID microchip, allowing wireless measurement. The prototype circuit, designed with a $0.35\text{-}\mu\text{m}$ CMOS technology, has the chip area, including pads, of 0.4mm^2 . Experimental results show that the circuit can operate from 2 to 3.3V supply voltage and has a resolution of 10 bits or 0.19°C . The circuit consumes average power up to $20.45\mu\text{W}$ at 2.4V power supply and at 27°C . When operating with RFID microchip, the resolution is reduced to 8 bits or 0.76°C , due to substrate noise and power supply level in a microchip. After the one point calibration, the measurement error is less than 2°C in a measurement range 0°C to 100°C .

Department Electrical Engineering Student's signature Ohmmarin Sathusen
 Field of study Electrical Engineering Advisor's signature Yeah L
 Academic year 2004 Co-advisor's signature chit wfat

กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างยิ่งของ รศ.ดร.เอกชัย ลีลาวดี และ ดร. นัยวุฒิ วงศ์โคเมท อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น ต่างๆ ในการวิจัยด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณ บริษัท ชีลิคอน คราฟต์ เทคโนโลยี จำกัด ที่เอื้อเฟื้อโปรแกรมให้ใช้งานสำหรับ การทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการนำ้งจรที่ได้ออกแบบไปเจือสาร ขอขอบคุณ พี่ๆ ที่บริษัท ชีลิคอน คราฟต์ เทคโนโลยี จำกัด ที่สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ให้คำปรึกษาในการออกแบบวงจร ตลอดจน เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทดสอบวงจรรวม

นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกคนในห้องปฏิบัติการวิจัยออกแบบและประยุกต์ วงจรรวม (IDAR) ที่คอยห่วงใย ให้ช่วยเหลือตลอดจนคำแนะนำที่ดีต่างๆ มาโดยตลอด

ขอขอบคุณบ้านพิทักษ์ไทยลัย ซึ่งให้ความอนุเคราะห์มอบเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ บ้านพิทักษ์ฯ ฉุพลาสกรเน็มมหาวิทยาลัย เพื่อทดลองในวิภาคสหพัฒน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา และพี่ชายที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๙
สารบัญ	๙
สารบัญตาราง	๖
สารบัญภาพ.....	๗
บทที่ 1 บทนำ.....	๑
1.1 แนวเหตุผลในการทำวิทยานิพนธ์.....	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๒
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	๒
1.4 วิธีดำเนินการวิจัย.....	๒
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๓
1.6 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย.....	๓
บทที่ 2 วงจรดุดันภูมิแบบดิจิทัลและการทำงานร่วมกับระบบ RFID	๔
2.1 บริทวนน์รวมกรรรม.....	๔
2.2 ภาพรวมของวงจรดุดันภูมิ.....	๖
2.3 วงจรดุดันภูมิและสวัสดิ์สัญญาณอ้างอิง.....	๖
2.3.1 แรงดันผลต่างซ่องว่างพลังงานและกระแสไฟฟ้า.....	๗
2.3.2 กระแสอ้างอิง.....	๙
2.4 ตัวแปลงเอนะล็อกเป็นดิจิทัล.....	๑๐
2.4.1 ตัวแปลงแบบดูอัลสโลป (Dual Slope ADC).....	๑๑
2.4.2 ตัวแปลงแบบซิกมาเดลต้า (Sigma-Delta ADC).....	๑๒
2.5 วงจรควบคุมภาคดิจิทัล.....	๑๔
2.6 การทำงานของวงจรดุดันภูมิร่วมกับ RFID.....	๑๕
2.7 สรุปท้ายบท.....	๑๖
บทที่ 3 การออกแบบและผลจำลองการทำงาน	๑๗
3.1 ความไม่เป็นอุดมคติ (Non-ideality).....	๑๗
3.1.1 ความไม่เข้าคู่ของทรานซิสเตอร์แบบมอส.....	๑๘

3.1.2	ความไม่เข้าคู่ของตัวด้านหน้าและตัวเก็บประจุ	19
3.1.3	ความไม่เข้าคู่ของทรานซิสเตอร์ไปโพลาร์	19
3.1.4	ความคลาดเคลื่อนของแรงดันเบสอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ไปโพลาร์	20
3.1.5	ความไม่เป็นเชิงเส้นของกระแสอ้างอิง	20
3.2	การปรับเทียบ (Calibration)	21
3.2.1	การปรับเทียบทนีจุด	22
3.2.2	การปรับเทียบสองจุด	23
3.3	วงจรดดอุณหภูมิและวงจรสร้างกระแสอ้างอิง	24
3.3.1	การสตาร์ทอัพวงจร	24
3.3.2	วงจรสร้างกระแสที่แปลงตามอุณหภูมิและกระแสอ้างอิง	26
3.3.3	วงจรชดเชยความโถ่ของกระแสอ้างอิง	29
3.3.4	ผลของสมบประสิทธิ์อุณหภูมิของตัวด้านหน้า	31
3.3.5	วงจรสร้างแรงดันใหม่ร่วมสำหรับตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล	33
3.3.6	การหยุดการทำงานของวงจร	34
3.4	ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบซิกมาเดลต้า (Sigma-Delta ADC)	35
3.4.1	อปเปนโซลีดและตัวเก็บประจุสำหรับการอินทิเกรต	37
3.4.2	ตัวเบรียบเทียบระดับแรงดัน	41
3.5	วงจรควบคุมภาคดิจิทัล	44
3.6	การจำลองการทำงานทั้งระบบ	47
3.7	สรุปท้ายบท	51
บทที่ 4	การวัดลายวงจรรวม	53
4.1	วงจรดดอุณหภูมิและสร้างกระแสอ้างอิง	53
4.2	ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล	56
4.3	วงจรควบคุมภาคดิจิทัล	56
4.4	การทำหนดแพดและการวางแผนแพด (Pad)	56
4.5	การวัดลายวงจรรวม	57
4.6	สรุปท้ายบท	59
บทที่ 5	การทดสอบวงจรรวม	60
5.1	การทดสอบวงจรดดอุณหภูมิที่ทำงานเป็นอิสระ	60
5.2	การทดสอบวงจรรวมดดอุณหภูมิที่ทำงานร่วมกับชิป RFID	67
5.3	สรุปท้ายบท	70

บทที่ ๖ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ.....	71
6.1 ข้อสรุป.....	71
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	72
รายการอ้างอิง.....	74
ภาคผนวก.....	77
ภาคผนวก ก	
ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบซิกมาเดลต้าและการจัดสัณฐานสัญญาณรบกวน.....	78
ภาคผนวก ข	
บทความที่ได้รับการพิจารณาตอบรับในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27.....	82
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	87

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 งานวิจัยที่ได้มีมาก่อนเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ	5
ตารางที่ 2-2 วงจรรวมวัดอุณหภูมิที่มีจุดน้ำยาทั่วไป	5
ตารางที่ 3-1 คุณสมบัติของตัวด้านท่านแต่ละชนิด	31
ตารางที่ 3-2 ขนาดของทราบซิสเตอร์ภายในวงจรอปเปอมป์	38
ตารางที่ 3-3 ผลการจำลองการทำงานของอปเปอมป์	40
ตารางที่ 3-4 ขนาดของทราบซิสเตอร์ภายในตัวเปรียบเทียบระดับแรงดัน	42
ตารางที่ 3-5 เวลาในการเปรียบเทียบของตัวเปรียบเทียบที่ผลต่างแรงดันขาเข้าค่าต่างๆ	42
ตารางที่ 3-6 ผลการจำลองการทำงานในสภาวะความแปรปรวนต่างๆ	49
ตารางที่ 4-1 รายละเอียดและหน้าที่ของแพดสำหรับทดสอบวงจร	57
ตารางที่ 5-1 ผลการวัดอุณหภูมิโดยตรงจากวงจรรวมที่ทำงานเป็นอิสระ	64
ตารางที่ 5-2 ผลการวัดอุณหภูมิและกระแสที่แรงดันไฟเลี้ยงต่างๆ	66
ตารางที่ 5-3 ผลการวัดอุณหภูมิของวงจรรวมวัดอุณหภูมิภายในชิป RFID	68

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญภาพ

หน้า

รูปที่ 2-1 ส่วนประกอบของวงจรวัดอุณหภูมิ	6
รูปที่ 2-2 วงจรสร้างแรงดันผลต่างช่องว่างพลังงาน	7
รูปที่ 2-3 วงจรสร้างกระแสที่แปรผันตามอุณหภูมิหรือกระแสพีเก็ต	8
รูปที่ 2-4 วงจรสร้างกระแสอ้างอิงจากกระแส I_{PTAT} และ I_{VBE}	9
รูปที่ 2-5 วงจรสร้างกระแสที่แปรผันตามแรงดันคร่อมเบสกับอimitเตอร์ (I_{VBE})	9
รูปที่ 2-6 วงจรของตัวแปลงเอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบดูอัลสโลป	11
รูปที่ 2-7 สัญญาณเชิงเวลาของแรงดันข้าออกินทิเกรเตอร์ ที่กระแสขาเข้าค่าต่างๆกัน	12
รูปที่ 2-8 การทำงานของตัวแปลงเอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบซิกมาเดลต้าอันดับหนึ่ง	12
รูปที่ 2-9 สัญญาณเชิงเวลาของแรงดันภายในมอดูลเตอร์แบบซิกมาเดลต้า	13
รูปที่ 2-10 ส่วนประกอบของระบบ RFID ซึ่งมีวงจรวัดอุณหภูมิอยู่ภายในชิป RFID	16
รูปที่ 3-1 วงจรสะท้อนกระแสเบื้องต้น	18
รูปที่ 3-2 ความผิดพลาดของข้อมูลข้าออกเนื่องจากสาเหตุต่างๆ	21
รูปที่ 3-3 ลักษณะการปรับเทียบแบบหนึ่งจุดซึ่งเสมือนเป็นการหักล้างค่าออฟเซตกับที่รัดได้	22
รูปที่ 3-4 ลักษณะการปรับเทียบแบบสองจุดซึ่งเสมือนการสร้างเส้นตรงขึ้นมาใหม่เพื่อวัดค่า	22
รูปที่ 3-5 ขั้นตอนการปรับเทียบโดยใช้เทคโนโลยี RFID	23
รูปที่ 3-6 วงจรสำหรับการสตาร์ทอพ	24
รูปที่ 3-7 ผลการจำลองขณะสตาร์ทอพวงจร	25
รูปที่ 3-8 วงจรสร้างกระแสข้าออกที่มีค่าแปรผันตามอุณหภูมิ	26
รูปที่ 3-9 สัญญาณกระแสต่างๆในวงจรสร้างกระแสที่แปรผันตามอุณหภูมิและกระแสอ้างอิง	28
รูปที่ 3-10 วงจรชดเชยความโคลงของกระแสอ้างอิงแบบเชิงเส้นเป็นช่วงๆ	29
รูปที่ 3-11 กระแสต่างๆในวงจรชดเชยความโคลงของกระแสอ้างอิง	30
รูปที่ 3-12 กระแสอ้างอิงก่อนและหลังทำการชดเชยความโคลงด้วยวิธีชดเชยเชิงเส้นเป็นช่วงๆ	30
รูปที่ 3-13 อัตราส่วนของกระแส I_{TEMP} / I_{REF} และค่าของกระแสเมื่อร่วมผลของสัมประสิทธิ์ เชิงอุณหภูมิของตัวต้านทาน	32
รูปที่ 3-14 วงจรสร้างแรงดันใหม่ร่วมเพื่อป้อนให้กับตัวแปลงเอนะล็อกเป็นดิจิทัล	33
รูปที่ 3-15 ระดับแรงดันใหม่ร่วม(V_{CM}) ที่อุณหภูมิต่างๆ	33
รูปที่ 3-16 วงจรหยุดการทำงานของวงจรสร้างกระแสโดยแยกตามชนิดของทرانซิสเตอร์	34
รูปที่ 3-17 วงจรวัดอุณหภูมิและสร้างกระแสอ้างอิง (ไม่รวมส่วนของวงจรสร้างแรงดันใหม่ร่วม)	35

รูปที่ 3-18 ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบบีกามาเดลต้าอันดับหนึ่ง.....	36
รูปที่ 3-19 สัญญาณที่ใช้ควบคุมการทำงานของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล	36
รูปที่ 3-20 สัญญาณภายในวงจร模อคูเลเตอร์ขณะทำการแปลงค่า	36
รูปที่ 3-21 วงจรคอมปาร์โตร์โครงสร้างขยายขั้นเดียวแบบสะท้อนกระแส	38
รูปที่ 3-22 แบบจำลองของ模อคูเลเตอร์แบบบีกามาเดลต้าเมื่อมีผลของค่าทรานสistorตักแทนร์	39
รูปที่ 3-23 โครงสร้างของวงจรเปรียบเทียบระดับแรงดันแบบพลวัต	41
รูปที่ 3-24 ผลการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบระดับแรงดันในช่วงเปรียบเทียบโดยค่าผลต่างของแรงดันขาเข้ามีค่า 1mV	43
รูปที่ 3-25 ผลการจำลองการทำงานของวงจรเปรียบเทียบระดับแรงดันทั้งหมด	43
รูปที่ 3-26 ผลการจำลองการทำงานของ模อคูเลเตอร์เมื่อป้อนสัญญาณกระแสเข้าเป็นสัญญาณไซน์ความถี่ 400 Hz	44
รูปที่ 3-27 ผลการวิเคราะห์เชิงความถี่ของสัญญาณพัลส์จาก模อคูเลเตอร์	44
รูปที่ 3-28 ส่วนประกอบของวงจรควบคุมภาคดิจิทัล	45
รูปที่ 3-29 แผนภาพการขั้นตอนการทำงานของวงจรซึ่งถูกควบคุมโดยวงจรควบคุมภาคดิจิทัล	45
รูปที่ 3-30 ผลจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัล (ช่วงของการเริ่มต้นการทำงาน)	47
รูปที่ 3-31 ผลจำลองการทำงานของวงจรดิจิทัล (ช่วงของการหยุดการทำงานและแสดงผล)	47
รูปที่ 3-32 ผลจำลองการทำงานของวงจรวัดอุณหภูมิร่วมกับตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลที่อุณหภูมิ -40°C	48
รูปที่ 3-33 ผลจำลองการทำงานของวงจรวัดอุณหภูมิร่วมกับตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลที่อุณหภูมิ 27°C	50
รูปที่ 3-34 ผลจำลองการทำงานของวงจรวัดอุณหภูมิร่วมกับตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลที่อุณหภูมิ 120°C	50
รูปที่ 3-35 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับค่าดิจิทัลข้าออกที่อ่านค่าได้จากค่าเต็มสเกลขนาด 12 บิตซึ่งเมื่อเทียบเป็นเลขฐานสิบจะมีค่า 4096	50
รูปที่ 4-1 ลายวงจรของวงจรสร้างกระแสที่แบร์เพนตามอุณหภูมิและกระแสอ้างอิง	54
รูปที่ 4-2 ลายวงจรของตัวต้านทานแบบผสม	55
รูปที่ 4-3 ลายวงจรของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบบีกามาเดลต้า	55
รูปที่ 4-4 ลายวงจรของวงจรควบคุมภาคดิจิทัล	55
รูปที่ 4-5 ลายวงจรรวมของวงจรรับสัญญาณ	58
รูปที่ 5-1 วงจรสำหรับทดสอบวงจรรวมรับสัญญาณ	61

รูปที่ 5-2 ลายวงจรของแผ่นพีชีปีสำหรับทดสอบความรวม	61
รูปที่ 5-3 ลักษณะของสัญญาณ conv_en และ dout	62
รูปที่ 5-4 ลักษณะของสัญญาณ conv_en และ dout ในขณะทำการเลื่อนบิตข้อมูลออกมา	62
รูปที่ 5-5 ค่าความผิดพลาดของวงจรวัดอุณหภูมิเมื่อทำการวัดโดยตรงก่อนปรับเทียบ	65
รูปที่ 5-6 ค่าความผิดพลาดของวงจรวัดอุณหภูมิเมื่อทำการวัดโดยตรงหลังปรับเทียบ แบบหนึ่งจุด	65
รูปที่ 5-7 ระบบทดสอบการวัดอุณหภูมิซึ่งอยู่ภายใต้ชิป RFID	67
รูปที่ 5-8 ค่าความผิดพลาดของวงจรวัดอุณหภูมิเมื่อทำการวัดผ่านชิป RFID	69
รูปที่ 5-9 ค่าความผิดพลาดของวงจรวัดอุณหภูมิเมื่อทำการวัดผ่านชิป RFID หลังปรับเทียบ แบบหนึ่งจุด	69

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย